

BGA Engine MaFi-638

The most powerful BGA rework system

- ... Desoldering a BGA or CSP
- ... Removing old solder and residue
- ... Reballing a BGA or CSP
- ... Positioning and Placing a BGA or CSP
- ... BGA Soldering

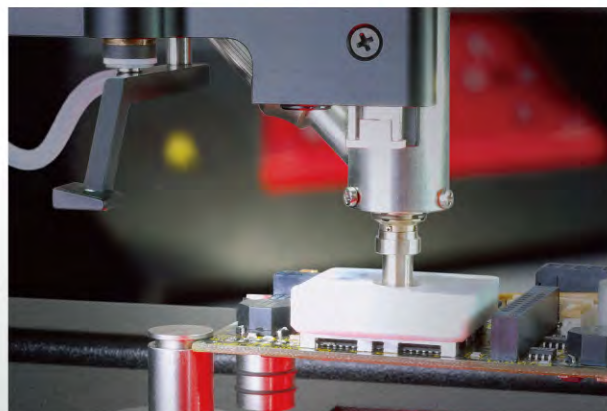
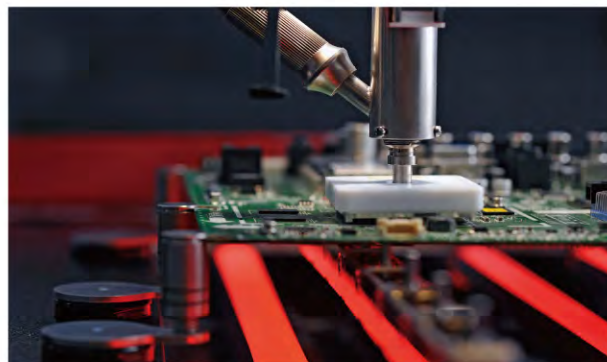


MaFi-638 完美的完成BGA返修之任務, 任意類型, 不同尺寸大小的BGA / Filps chip甚或是QFN元件都能在極簡易且安全的操作下完成拆 / 迴焊搭載全新雙模底部加熱器後的MaFi-638不僅能輕易的達成BGA拆焊 / 迴焊同時也能輕鬆的完成除錫 / 植球等全方位返修工作的目標 (獨一無二的視覺對位系統, 配合自動化置放系統造就了市場上精度最高的返修工作站系統)

配合功能強大的雙模底部加熱器與高精準熱風系統, 使用專屬的真空除錫筆更可絲毫不傷Pads的將殘留錫清除一空



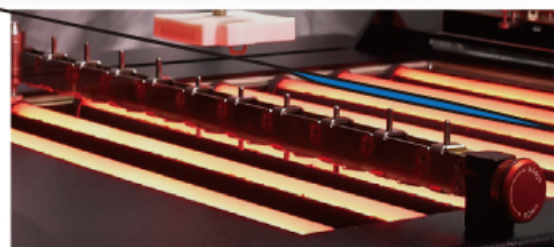
全新雙模底部加熱器



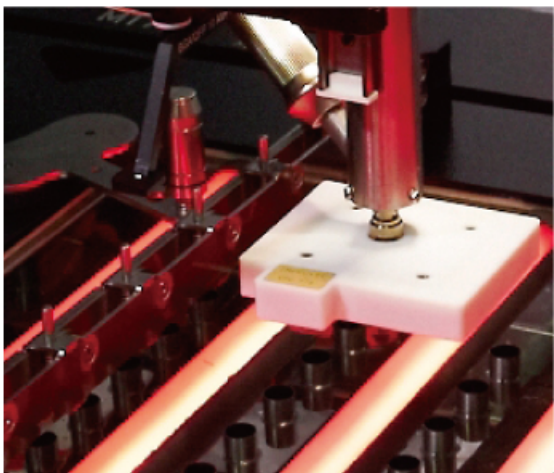
藉由簡單的點擊幾個功能按鈕強大的視覺對位系統即可自動的對BGA零件位置與角度做精確計算, 並藉由步進馬達系統將該元器件準確的自動置放於正確位置上.

BGA Engine MaFi-638

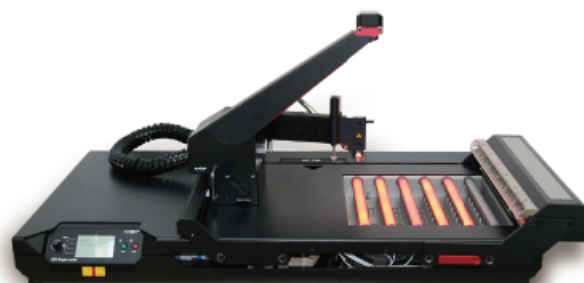
The most powerful BGA rework system



獨特的底部支撐架, 能夠完美的記憶PCB底部高低起伏之高度差, 如同記憶枕般提供PCB完美的支撐



功能強大的全新雙模底部加熱器, 快速及時且非常均勻的提供底部預熱能量, PCB受熱就像在迴焊爐一般, 保持最低PCB板彎扭曲量



MaFi-638 BGA Engine

Specification

Power Input	230V / 50 Hz 25 A
Pressure Input	5.5~8 Bar
Hot air power output	10~250 W / 40V
Hot air volume	2.0~35 L / Min
Hot air temp	150~400°C± 1%
Underheater power	1200~3000 W
Underheater size	245 x 275 mm
PCB size	400 x 500 mm
CCD camera resolution	1944 x 2595 pixel
Auto placement stroke	X-Y-Z / 75-75-40 mm
Auto placement angle	±10 °
CCD lighting	LED
PCB clipping	smart clip
PCB supporting	Flex Fix pin bar supporter (optional)
Weight	approx. 40 Kg
Communication Link	USB
Program software	Easy Solder
Thermo sensors	2 + 4
Hot air nozzle	CSP 4 pieces (covering all specs) optional
(all nozzles are optional)	BGA15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 31 / 32 / 33 / 35 / 37.5 / 40 / 40.5 / 45 / 46mm... Socket 478B / 775 / 1207 / 1165 / 1366 / 1567

TekServe® 欣岩企業有限公司

221新北市汐止區新台五路一段102號5樓
TEL: +886-2-26417388
<http://www.tekserve.com.tw>
E-Mail: info@tekserve.com.tw

深圳 TEL: +86-755-28183210~6 / 上海 TEL: +86-21-64325538 / 蘇州 TEL: +86-512-89186116 / 香港 TEL: +852-27245678